

CF-T23 FSE Cluster PVD 多層金屬濺鍍系統操作程序

操作程序：

- 1 登入 Web 系統，開啟設備使用畫面（刷卡開機）。
- 2 點選主畫面。
- 3 登入使用權。

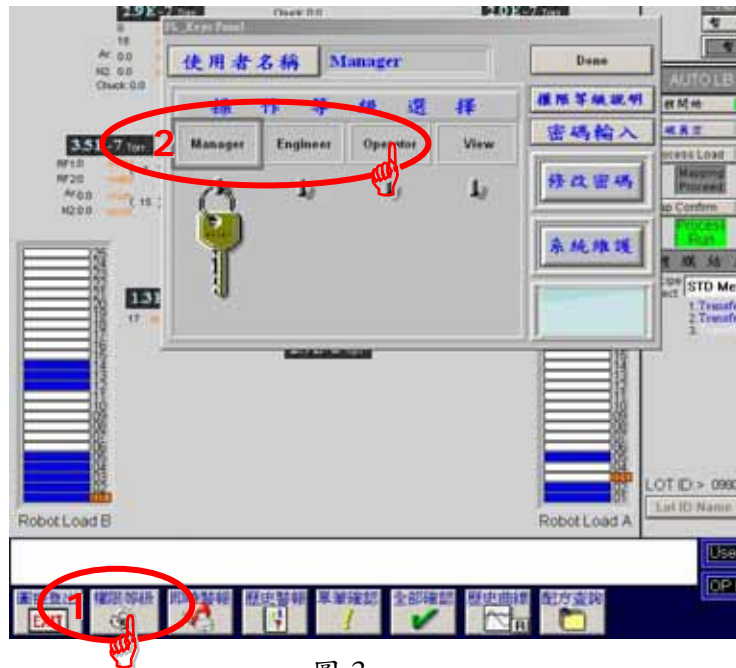


圖 3

- 4 輸入 LOT ID。 (key in ID 後按 enter，再按 **Lot ID Name Save** 儲存)

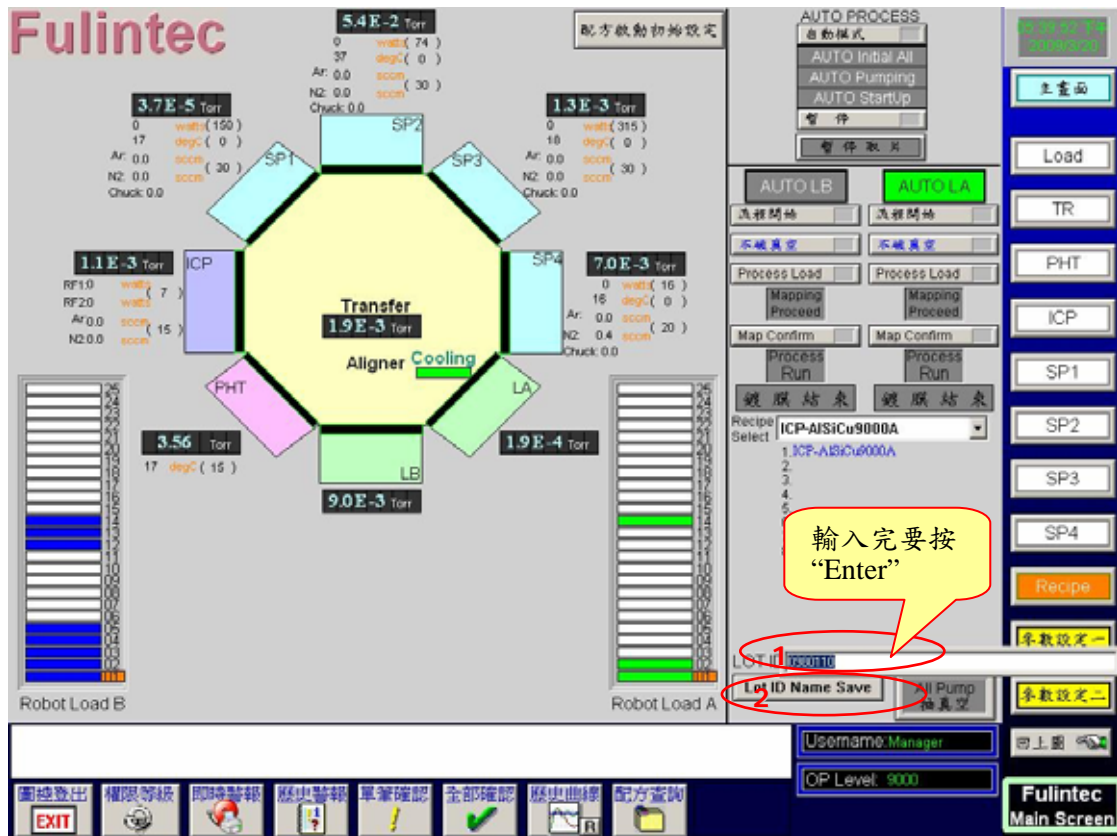


圖 4

CF-T23 FSE Cluster PVD 多層金屬濺鍍系統操作程序

5 選擇 Recipe，並執行 **配方啟動初始設定**。

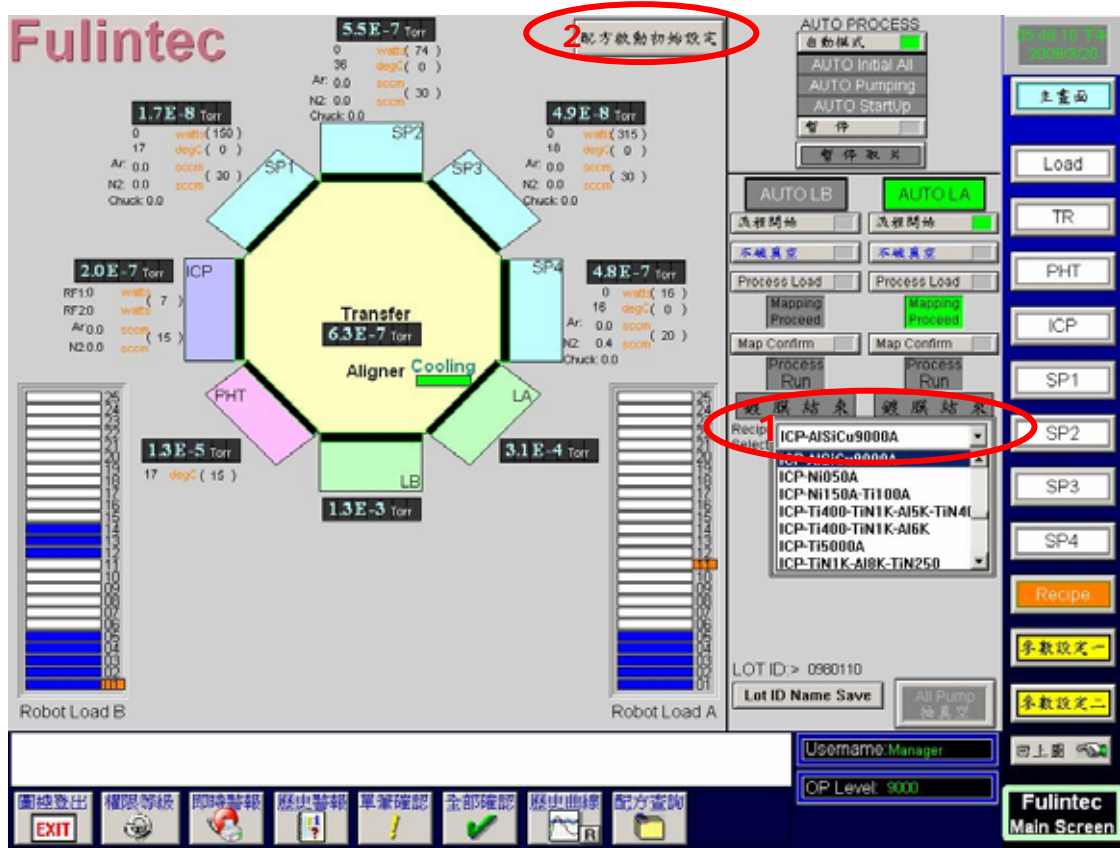


圖 5

6 開始執行 **自動模式**，待 **AUTO StartUp** 燈號變綠色，完成自動初始化確認。



圖 6

7 真空執行模式選擇，請選擇“破真空”。

CF-T23 FSE Cluster PVD 多層金屬濺鍍系統操作程序

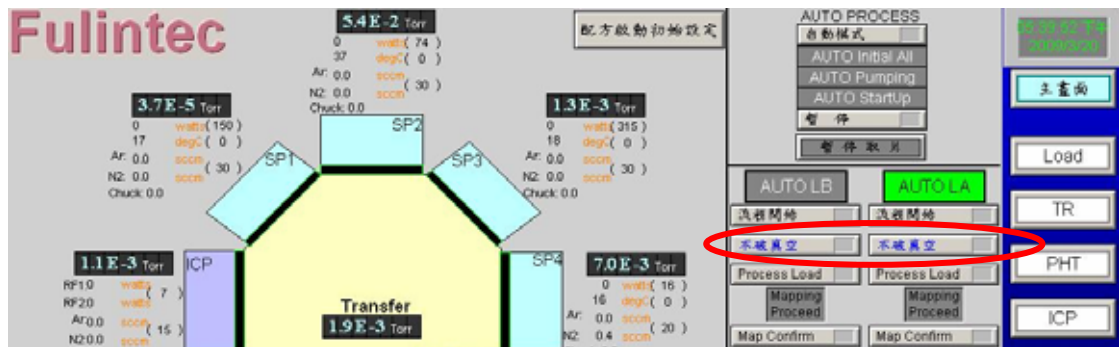


圖 7

- 8 執行 **流程開始** (依需求選擇 AUTO LA 或 AUTO LB) 此時“流程開始”燈號顯示綠色，待 Loadlock VENT 完畢，Chamber Door 會自動打開，“Process Load”燈號呈現綠色閃爍狀。



圖 8

- 9 將 wafer (含額外控片 2 片) 放入 PVD 專用之黑色 Cassette 中，並檢查委託件 wafer，是否有任何異狀(髒污、光阻、刮傷、缺角、片數不對、刻號不對...)，並於 run card 紀錄異狀，必要時聯絡貨主。
- 10 以平邊器將 wafer 平邊調整朝上 (朝外)。
- 11 將 Cassette 放入 LA (或 LB) 中，並確認正確放入導槽中。
- 12 執行 **Process Load**，“Process Load”綠色燈號熄滅，“Mapping Proceed”綠色燈號亮起，台會將 Chamber Door 關閉，開始 Mapping。

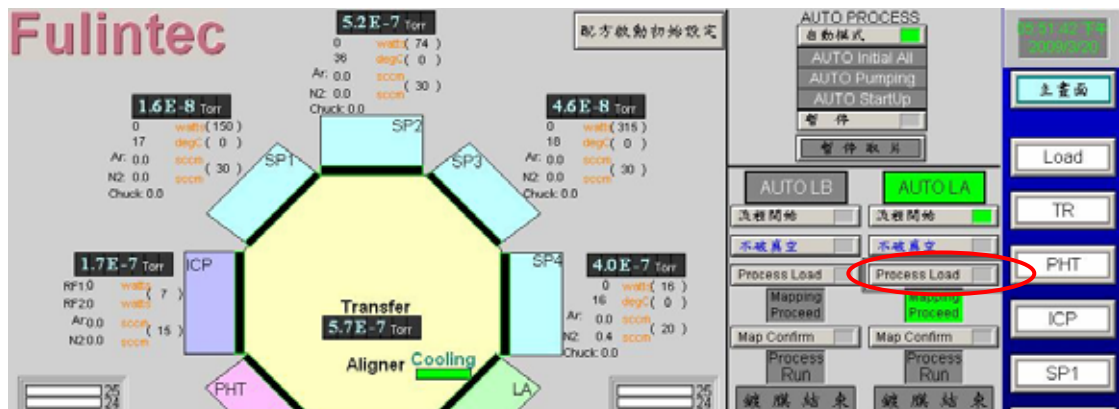


圖 12

- 13 待 Mapping 完成，“Mapping Confirm”燈號呈現綠色閃爍狀，確認 wafer Mapping data 無誤 (需含額外控片 2 片)，必要時可刪去不要 run 的片數。

CF-T23 FSE Cluster PVD 多層金屬濺鍍系統操作程序

- 14 按下 **Map Confirm** 開始鍍膜。(再確認 Lot ID、recipe 內容及片數無誤，且 Map Confirm 燈號呈綠色閃爍狀態)。

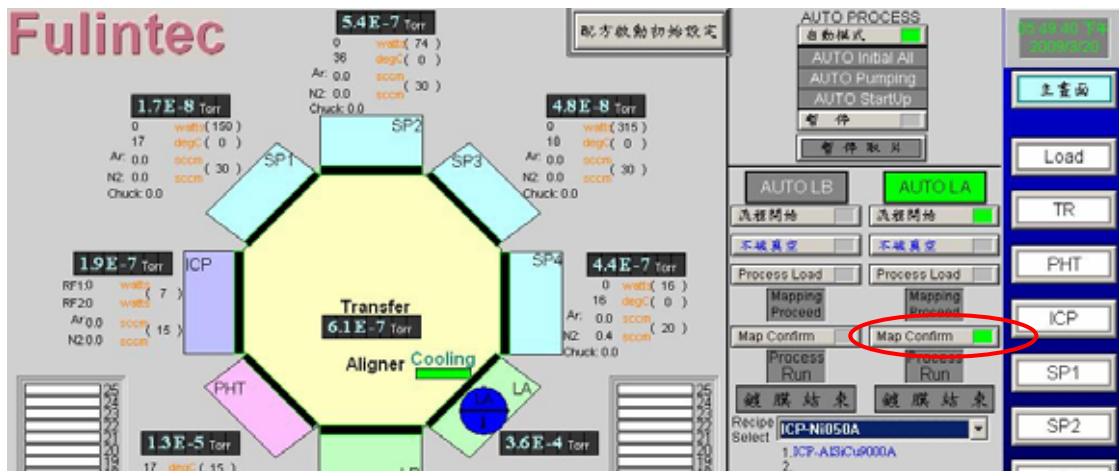


圖 14

- 15 觀察第 1 片(控片)流程是否有誤。
- 16 待製程執行完畢，確認螢幕“鍍膜結束”燈號已顯示綠色，且螢幕上所有指定 wafer 皆已變成綠色。

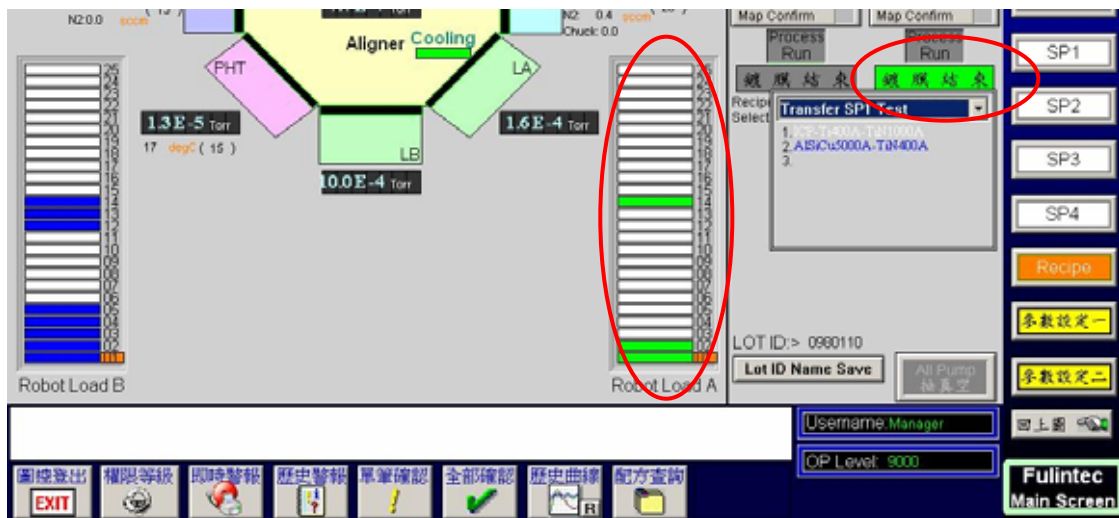


圖 15

- 17 再執行一次 **流程開始** (同步驟 8)，待 Loadlock Door 開啟時，將 Cassette 取出。
- 18 從 PVD 專用 Cassette 中將 wafer 取出，並檢查 wafer 鍍膜有無異狀(破片、缺角、未鍍膜...)。
- 19 若需繼續 run 貨，則重複步驟 11~18。若結束 run 貨，則繼續以下流程。
- 20 將 Cassette 放回 LA(或 LB) 中，並確認正確放入導槽中。
- 21 執行 **Process Load**，機台會將 Chamber Door 關閉。

CF-T23 FSE Cluster PVD 多層金屬濺鍍系統操作程序

- 22 再按一次 **流程開始**，停止 AUTO LA(or LB) 流程，確認“流程開始”綠色燈號熄滅。(圖 8)
- 23 再按一次 **自動模式**，停止 AUTO PROCESS 流程，確認“自動模式”綠色燈號熄滅。(圖 6)
- 24 執行 **All Pump 抽真空**，保持所有 chamber 在抽真空狀態。

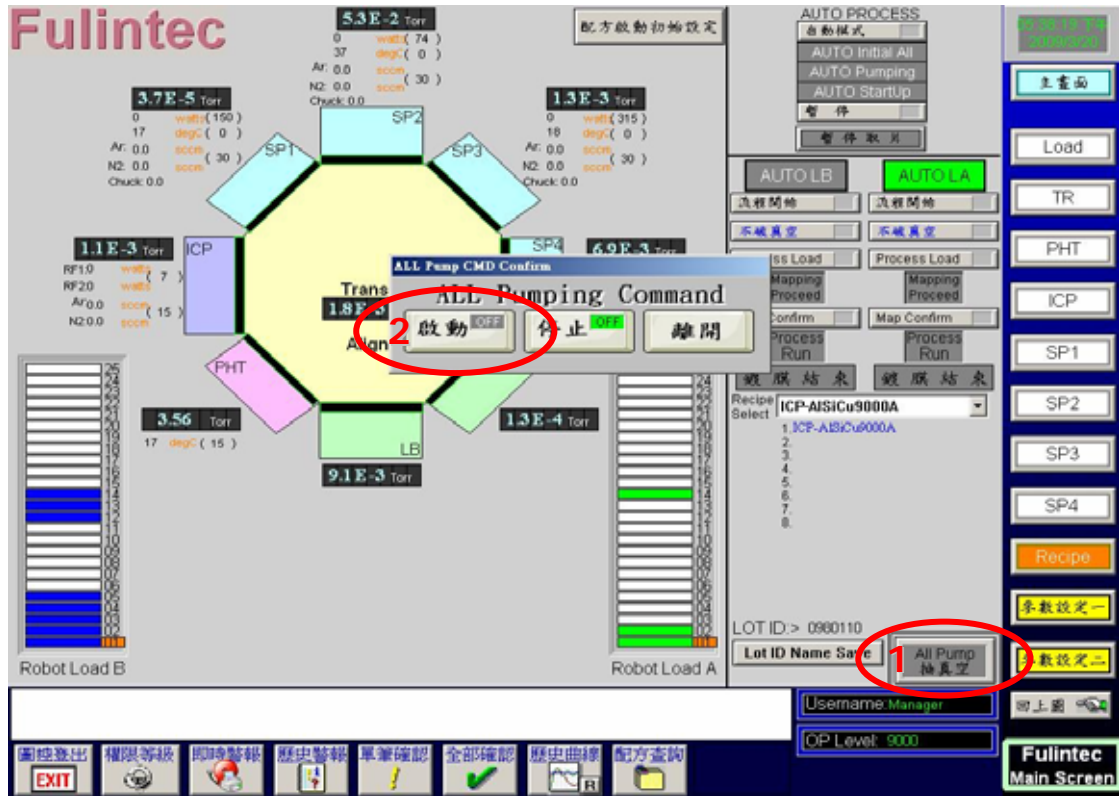


圖 24

- 25 登出使用權。

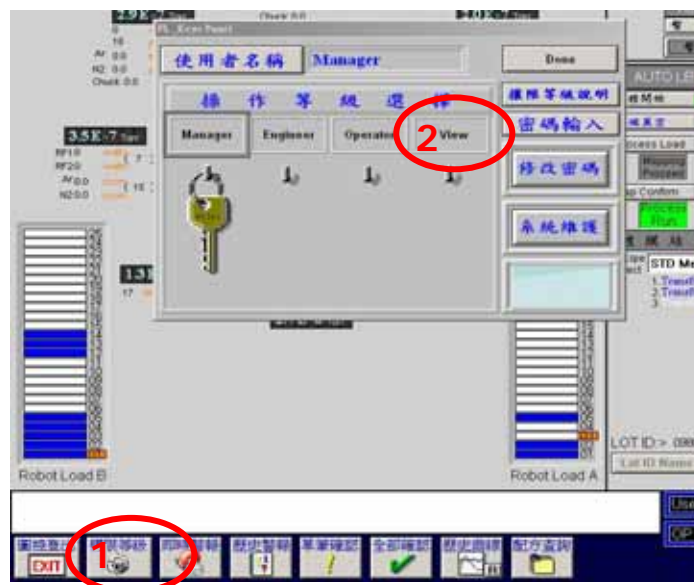


圖 25

- 26 登出 Web 系統 (刷卡關機)。